



CMP 技術の基礎を理解するウインターキャンプ 2022

(公社)精密工学会 プラナリゼーション CMP 委員会

日時

2022年12月16日(金)8:30-16:00

方式

Zoom を使った LIVE 配信セミナー

対象者・募集人数

対象者： CMP に携わる研究者、技術者からマーケティング、営業にいたるビジネスパーソン
及び半導体デバイス製造技術の基礎を理解されたい方

募集人数： 50 名

概要

本セミナーは、半導体製造前工程における CMP 技術を基礎から先端プロセス動向まで網羅した分かりやすい説明をします。さらに半導体デバイス製造技術の前工程プロセスと後工程プロセスを、幅広く説明をします。サマーキャンプ 2022(2022.8.26-8.27 開催)の講義を踏まえて、各分野の先端技術の動向を紹介します。専門技術である CMP に加え、半導体デバイス製造技術全般を理解する入門講座としておすすめのセミナーです。

講師

ワイドヴィル 廣田 良浩

株式会社 ISTL 磯部 晶

グローバルネット株式会社 武野 泰彦

ウエスタンデジタル合同会社 山田 洋平 (ファシリテーター)

効果・到達目標

座学のみならず、ワールドカフェによるグループ討議を通じた受講者間交流を含めた講師・受講者双方向の能動的な学習を行うことにより、CMP 技術と半導体製造技術の理解を深める。

スケジュール

12月16日(金)

オープニングセレモニー 8:30-8:45

ロジック・メモリデバイスの基礎と先端プロセス動向 8:45-10:15

講師 廣田 良浩

CMP 技術基礎 10:30-11:00

講師 礒部 晶

ワールドカフェ 11:00-12:00

ファシリテーター 山田 洋平

休憩 12:00-13:00

先端 CMP 技術 13:00-14:00

講師 礒部 晶

半導体製造後工程プロセス基礎と 3次元実装動向 14:15-15:45

講師 武野 泰彦

クロージングセレモニー 15:45-16:00

受講料

15,000 円(一般参加)

10,000 円(サマーキャンプ 2022 参加者および学生)

- a. お申し込み者数が定員に達している場合には、お申し込みいただけない場合があります。
- b. やむを得ずキャンセルの場合は、原則開催日の前営業日の午後 3 時までにご連絡をください。
- c. 開催日当日のキャンセルの場合は、受講料を全額ご請求いたします。
- d. 代理参加は受付いたします。
- e. 特典として今回初めて参加される方には、**図解 半導体用語集 2022 年版**(サクセスインターナショナル株式会社 制作・監修、グローバルネット株式会社発行)を進呈いたします。

受講について

・配布資料

開催前日までに PDF にてお送りいたします。

無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

・Zoom を使った WEB 配信セミナー受講の手順

Zoom を使用されたことがない方は、[こちら](#)からミーティング用 Zoom クライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。

開催日直前に WEB セミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始 10 分前までに招待メールに記載されている視聴用 URL より WEB 配信セミナーにご参加ください。

お申込み

ホームページからのオンライン参加登録をご利用ください。

連絡先

「プラナリゼーション CMP 委員会」事務局(三上)

TEL; 03-5117-2225/FAX; 03-5117-2223

Email:mikami@global-net.co.jp